

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年8月14日(14.08.2025)

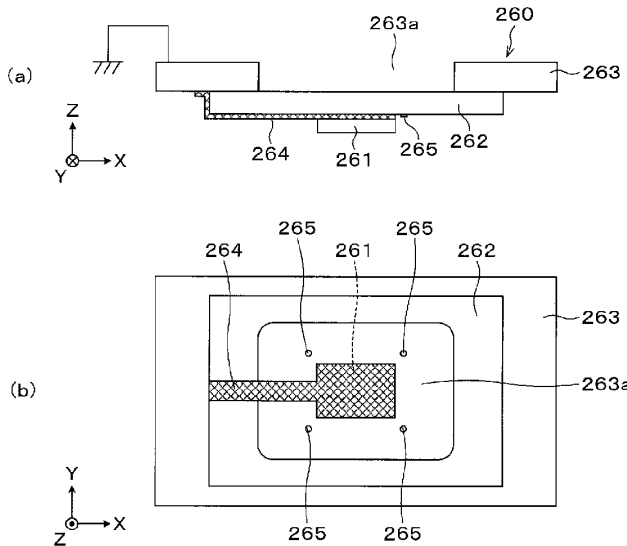


(10) 国際公開番号
WO 2025/169810 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/60 (2006.01) *H01L 21/677* (2006.01)
H01L 21/52 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2025/002752
- (22) 国際出願日: 2025年1月29日(29.01.2025)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2024-017095 2024年2月7日(07.02.2024) JP
- (71) 出願人: 東京エレクトロン株式会社(TOKYO ELECTRON LIMITED) [JP/JP]; 〒1076325 東京都港区赤坂五丁目3番1号 (JP).
- (72) 発明者: 三根 陽介(MINE, Yousuke); 〒8691232 熊本県菊池郡大津町高尾野272-4 東京エレクトロン九州株式会社内 (JP).
中満 孝志(NAKAMITSU, Takashi); 〒8611116 熊本県合志市福原1-1 東京エレクトロン九州株式会社内 (JP).
- (74) 代理人: 金本 哲男, 外(KANEMOTO, Tetsuo et al.); 〒1620065 東京都新宿区住吉町1-20 角張ビル 曙国際特許事務所 (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG,

(54) Title: BONDING DEVICE

(54) 発明の名称: 接合装置



(57) Abstract: A bonding device for bonding a plurality of dies to a target substrate, the bonding device comprising a substrate holding unit for holding the target substrate, and a head unit for bonding the dies to the target substrate held by the substrate holding unit, the head unit comprising: an electrically conductive bond head for holding the dies; an insulator that holds the bond head; and a ground connection body that connects the bond head to ground potential.

[続葉有]

KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU,
LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY,
MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL,
PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK,
SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UY, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

(57) 要約: 複数のダイを対象基板に接合する接合装置であって、前記対象基板を保持する基板保持部と、前記基板保持部に保持された前記対象基板に前記ダイを接合するヘッド部と、を有し、前記ヘッド部は、前記ダイを保持し、導電性を有するボンドヘッドと、前記ボンドヘッドを保持する絶縁体と、前記ボンドヘッドをグランド電位に接続するグランド接続体と、を有する。